

Investor Relations 2018

Your Most Trustworthy



유의 사항

Disclaimer

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

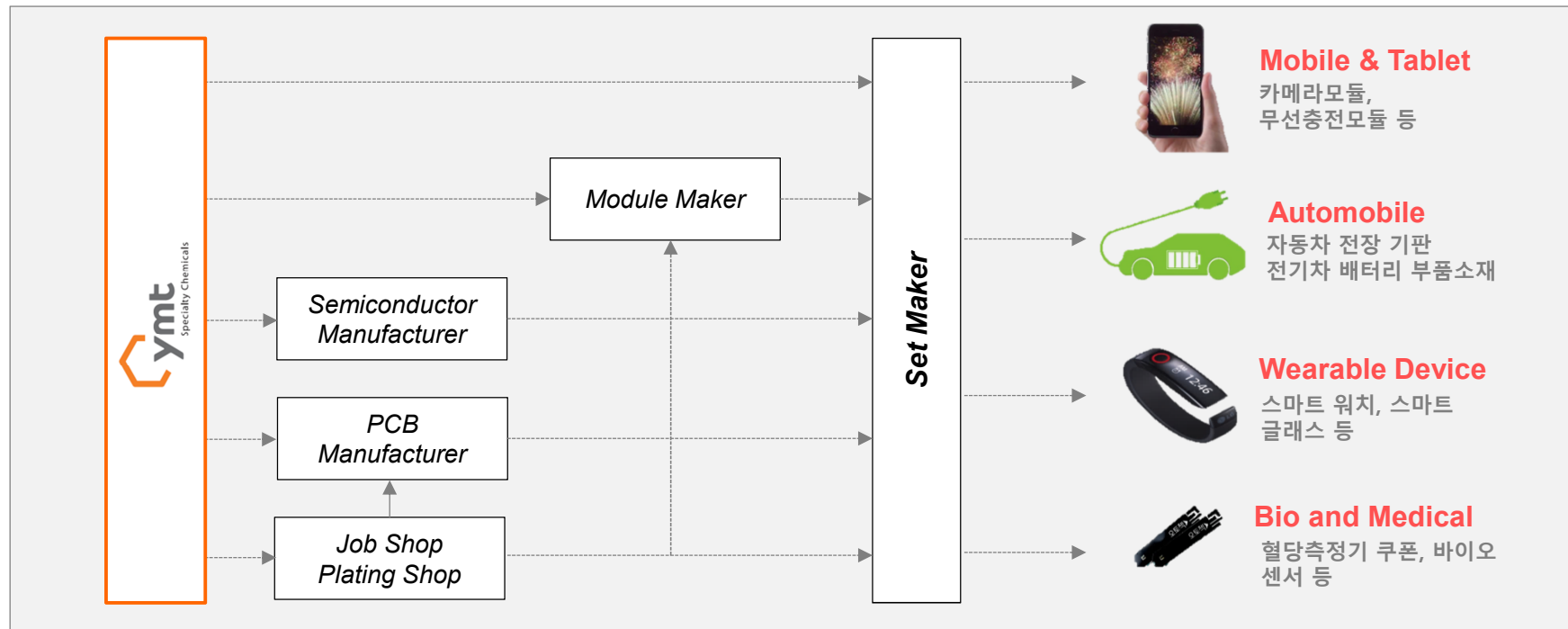
회사 개요

Company profile

Business Overview

와이엠티는 전자소재 산업에서 반드시 필요한 **화학소재를 직접 개발 / 제조 / 납품하는 회사**로써, 모바일 뿐만 아니라 전기자동차, 웨어러블 디바이스, 바이오 센서 등에서도 그 가치를 인정받고 있습니다.

- ✓ 주요 표면처리 분야 : 무전해금도금 프로세스 [Soft ENIG / ENIG / ENEPIG] , 무전해 화학동, 프로세스 케미컬
- ✓ 주요 고객사 : 영풍전자, 삼성전기, 인터플렉스, 비에이치, Foxconn 등



Supplier of Advanced Electronic Materials

YMT Co.,Ltd.

- 회사명 • 와이엠티(주)
- 설립일 • 1999. 02. 11
- 대표자 • 전성욱 (표면처리 기술사)
- 종업원 • 본사 147 (한국 : 137명 / 대만 10명)
- 소재지 • 인천광역시 남동구 남동동로 153번길 30
- 자본금 • 3,702.6 백만원
- 주요제품
 - PCB 화학소재
 - 전자소재 분야
 - 표면처리외주도금[YPT]
- 주요시장
 - 모바일용 기판 및 모듈
 - 무선충전기용 모듈
 - Auto mobile 용 전장 부품
 - 바이오 센서 등

YMT 계열사

YMT Shenzhen

- PCB 화학소재 중국 판매 법인
- 심천에 위치하고 있으며, 중국 및 대만계열 고객사 확보

YMT Taiwan Branch

- PCB 화학소재 대만 판매지사
- Taoyuan 위치, 대만에 위치한 PCB 본사 영업

YMT Vina

- PCB 화학소재 판매 및 제조법인
- 박닌,빈푹성 위치, 베트남에 진출한 한국 고객사 확보

YPT

- 금도금 및 동도금 표면처리 외주 법인
- 안산에 위치, 한국 No.1 표면처리 외주 회사

Beyond Solution

- PCB용 장비 제조 및 판매

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정,박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다.이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Finish Plating chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

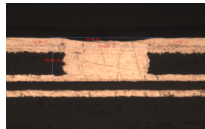
- ✓ PEN 855 Series

ENEPIG Process

- ✓ ELP Series
- ✓ IR Gold Series

TIN Plating process

- ✓ Bright and Matte finish
- ✓ Immersion tin process



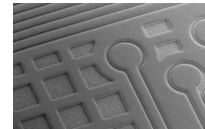
Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ Desmear Process
- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series
- ✓ ENPLA series

Electronic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ VFBJ Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

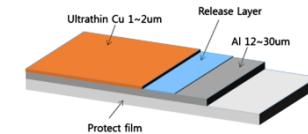
- ✓ DR Series
- ✓ SE Series
- ✓ SAC Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ TDF / MDF Series

Others

- ✓ Gold Recover
- ✓ Foamkiller Series
- ✓ CAROAT



Electronic Materials

Materials

- ✓ Ultra-thin copper Foil
- ✓ FCCL

Roll to Roll

- ✓ RTR 동도금 외주

기판 가공 [YPT]

Gold plating Outsourcing

- ✓ Soft ENIG / ENEPIG

Via-fill copper plating

사업 영역
Business area

주요 고객사 List

Set Maker						
Semi-conductor Maker						
PCB Maker						
						
Display 업체						

사업 영역
Business area

PCB Market & YMT Business area

		FPCB, RFPCB	HDI	PKG	RIGID
Customer	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> • SEMCO • BH Flex • Youngpoong • Interflex 	<ul style="list-style-type: none"> • SEMCO • Daeduck • LG Innoteck • KCC 	<ul style="list-style-type: none"> • SEMCO • Daeduck • LG Innoteck • KCC 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyunwoo
	Global	<ul style="list-style-type: none"> • Zhending Technology • Career • Unimicron • Mektron 	<ul style="list-style-type: none"> • AT&S • Zhending Technology • Ibsiden 	<ul style="list-style-type: none"> • AT&S • Zhending Technology • Ibsiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Various
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> • Market share expansion 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetration by SLP chemical in 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Globally, Small market share
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> • 15% ~ 20% in Korea market 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • 1Q. 2018 start 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> • Market expansion 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing
Finish Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> • Globally, over 50% 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Globally, Small market share
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing

< Finish Plating >

Soft ENIG Process



- ✓ FPCB 전용 금도금 프로세스
- ✓ 글로벌 M/S 및 기술력 1위
- ✓ 초 미세회로 구현 가능
- ✓ 삼성전자, 애플 제품 탑재



Copper plating chemical

[무전해 화학동도금 화학소재]

- ✓ 세계 최고수준의 기술력 보유
- ✓ 부도체 물질에 화학적 전도 성을 부여하는 공정

[전기동도금 화학소재]

- ✓ 동의 석출로 원하는 동 두께를 도금 하는 공정
- ✓ 원하는 위치와 두께를 형성하기에 적합

< Finish Plating >

ENEPIG Process



- ✓ 카메라 모듈등에 적합한 미세회로 최종 표면처리
- ✓ 글로벌 Top tier 점유율 확보
- ✓ 원가경쟁력 및 기술경쟁력 확보



회로공정 및 반도체 Chemical

[D.E.S Chemical]

- ✓ 세정,박리 등 PCB의 회로를 형성하기 위한 공정약품

[반도체 Chemical]

- ✓ Wet chemical (Cu etchant, UBM etchant) 등 신규시장 진입 Item

ENEPIG 공정 매출 확대

- 스마트폰 카메라 탑재 수 증가
 - ✓ 홍채인식/안면인식 등의 이유로 스마트폰 카메라 고사양화 진행
 - ✓ 대표적 High-end 스마트폰인 I-phone X의 경우 카메라 6대 적용 (전면 4, 후면 2)
 - ✓ 중국 Local 업체인 샤오미, 화웨이, 오포 등의 제조사 또한 전/후면 듀얼 카메라 를 채택
 - ✓ 스마트폰 카메라 고사양화에 따라, 카메라 모듈 프로세스인 ENEPIG 화학소재의 매출 확대 전망

동도금 매출 확대 전망

- 하이엔드(FPCB,RFPCB) 동도금 화학소재 성장
 - ✓ 특히 회로 세밀화 및 다층 기판[Multi layer]의 적층수가 증가됨에 따라 기존의 화학동 소재가 아닌 High-end 소재에 대한 고객사의 Needs 증가
 - ✓ 이에 따른 18년 FPCB & RFPCB 시장 동도금 점유율은 17년 10~15%, 18년 약 30% 수준으로 전망
- 고부가가치 PKG Substrate 으로의 영역 확대
 - ✓ FPCB, RFPCB의 Performance를 바탕으로 고가시장 진출
 - ✓ 외산 점유율이 매우 높은 시장에서 m/s 확대 기대

반도체 화학소재 시장 진출

- Wet Chemical 시장 진출
 - ✓ PCB process chemical 대비 고가약품 시장 진출
 - ✓ UBM Etchant, Cu Etchant 개발 완료 및 고객사 Test
 - ✓ 후공정 Bump 업체 target
- ✓ 향후 100% 외산이 점유하고 있는 Wafer 도금 시장 Target!

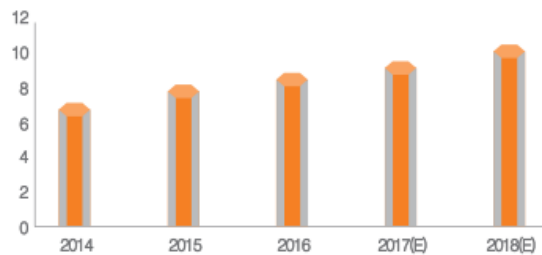
YPT(Out sourcing plating)

- Via-fill 장비 Set-up
 - ✓ RF PCB 등 고사양 PCB 동도금 외주 사업 진출 (Via-Fill 프로세스)
 - ✓ 17년 4분기 2 Line Set-up
- 베트남 시장 진출
 - ✓ 현재 Job-shop이 없는 베트남 시장 선점을 위해 YPT 공장 건설 진행
 - ✓ Major 고객과 협업을 통해 안정적인 시장 진입

Growth of Global Copper Foil Market

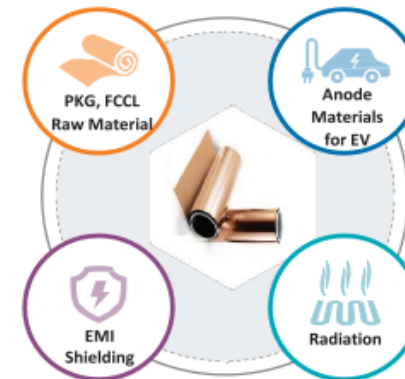
Global Electrolytic Copper Foil Market Value (Unit: KRW 1trn)

Reference: GosReports



- ✓ 동박시장은 EV & High-end 장치를 바탕으로 지속적으로 성장하고 있음
- ✓ Wearable & Foldable Display 같은 후속 산업의 발달로 High-end 동박 재료의 수요는 증가할 것으로 예상
- ✓ 일본의 M사가 전세계 시장의 대부분을 차지

Major Applications of Copper Foil



- ✓ YMT 동박은 세계적 트렌드인 "Thinner"를 충족하는 스펙
 - 이를 통해 Lighter EV, SLP, Substrate 등 극박을 요구하는 다양한 어플리케이션에 적용 가능
- ✓ 우수한 가격 경쟁력
 - 독자 개발 기술을 바탕으로 안정적인 가격, 고품질 가능
- ✓ 현재 국내/국외의 Major 업체와 샘플 테스트 진행 중

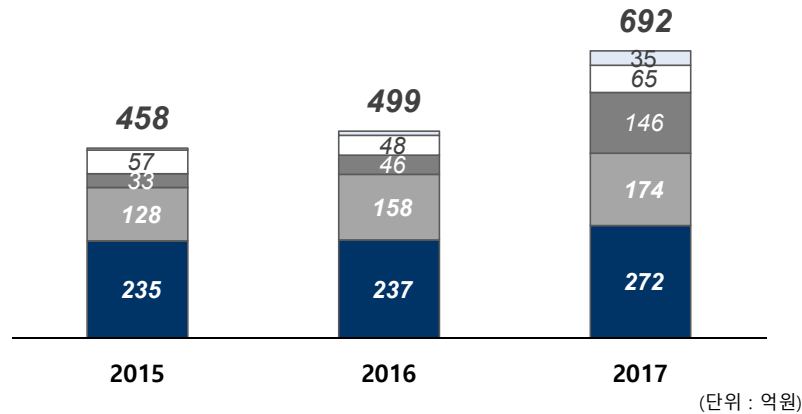
YMT가 독자 개발한 극동박 기술은 글로벌 특허에 침해되지 않은 독자적인 기술로 매우 높은 성장이 기대됨
17년 EMI 차폐 용 동박 양산 계획

사업 성과
Business performance

사업성과 및 재무제표

사업별 매출액 및 매출

■ 최종표면처리 ■ 기판가공 ■ 동도금 □ Process Chemical □ 기타 Total



	2015	2016	2017
Total	458	499	692
최종표면처리	235	237	272
기판가공	128	158	174
동도금	33	46	146
Process Chemical	57	48	65
기타	5	10	35

17년 재무제표

(단위: 억원)

	제 19 기	제 18 기
I. 매출액	691.9	499.4
II. 매출원가	415.3	292.8
III. 매출총이익	276.6	206.6
IV. 영업이익	160.8	110.8
기타수익	14.4	14.2
기타비용	13.0	9.7
금융수익	2.9	7.3
금융비용	44.5	19.6
V. 법인세차감전순이익	120.6	102.9
법인세비용	30.5	25.5
VI. 당기순이익	90.1	77.4
지배기업소유주지분	67.9	64.6
비지배지분	22.2	12.9

END OF DOCUMENT

감사합니다.